

平成30年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

平成30年4月17日
京都府中小企業技術センター
担当：応用技術課（担当 堀、東）
TEL：075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる技術である接合・実装技術に関して、生産現場の高度化に必要な課題や、各社が抱えている共通の問題をテーマとして、「京都実装技術研究会」を設置しています。

この度、平成30年度の会員を募集するためオープニングセミナーを下記のとおり開催します。

今回は、エレクトロニクス産業の世界的な動向と日本の状況や、最新鉛フリーはんだ等接合材料の動向・研究成果についての講演会です。

記

1 日 時 平成30年5月16日（水） 午後1時30分 ～ 午後5時

2 場 所 京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）研修室 5階

3 内容及び講師

(1) 「エレクトロニクス産業の世界的な動向と日本（電気自動車、IoT、ロボット、省エネ・環境パワーデバイス、MEMSセンサーなど）」

株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉 氏

講師は、産業タイムズ社において長くエレクトロニクス分野の取材、各分野の報道を手がけられ、現在、同社代表取締役社長としてご活躍されています。

今回は、電気自動車、IoT、ロボット、省エネ・環境がらみのパワーデバイス、MEMSセンサーなど、エレクトロニクス産業の世界的な動向と日本の立ち位置などについて、ご講演いただきます。

(2) 「最新 Pb フリーはんだ等接合材料の動向」

株式会社日本スペリア社 代表取締役 西村 哲郎 氏

講師は、株式会社日本スペリア社において、はんだ合金、フラックスの研究開発、販売マーケティング、Sn-Cu-Ni 系鉛フリーはんだ SN100C の開発などに携わってこられ、現在、同社代表取締役としてご活躍されています。

今回は、Pb フリーはんだによる接合過程の最新の研究成果と金属間化合物の特性、鉛フリーはんだに含有する物質の効果・影響、高温はんだの代替となる焼成用ナノ銀の現状について、ご講演いただきます。

4 定 員 70名（先着順・定員になり次第、締切りとします。）

5 参加費 無料

6 申込締切日 平成30年5月14日（月）まで

7 申込先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp